

2019年度「大学の世界展開力強化事業（中南米）」

短期派遣・異分野交流プログラム 派遣学生募集要項

1. 概要

(1) 趣旨・目的

本プログラムは、文部科学省「大学の世界展開力強化事業」（平成27～31年度）に採択された本学、東京外国語大学及び東京農工大学との共同事業「日本と中南米が取り組む地球的課題を解決する文理協働型人材養成プログラム」に基づき実施するものです。

中南米地域は豊富な天然資源や高い食料生産力を有するとともに、経済規模も大きいため、魅力的な市場として大きく発展する潜在力を有しています。今後、日本と中南米間の経済ならびに研究等の国際交流は益々盛んになっていくと予想されます。

本事業では、中南米諸国で取り組むべき環境、資源エネルギー、食料、社会・経済開発などの地球規模の課題を解決するために、3大学が連携・協働して実践型グローバル人材を養成します。

(2) 養成人材像

本事業で養成する人材像は、次のとおりです。

- ① 中南米が直面している地球規模課題の背景を理解し、解決するための幅広い教養と国際的に通用する環境・食料・エネルギー分野の知識を有し、自ら進んで課題解決に取り組む意欲と能力を有する人材
- ② 自国の文化だけでなく、敬意をもって相手国文化を学び、共に理解する姿勢と能力を有する人材
- ③ 語学力、論理的思考力および総合的な視野を有し、協調性を持って合意形成を導くことができる人材
- ④ 将来、日本と中南米との架け橋となりうる人材
- ⑤ 心身ともに健康な者

2. 海外短期派遣プログラム

(1) 派遣期間

2019年8月中旬以降の4週間程度

※出発日・帰国日は派遣決定後、派遣学生のスケジュール等を考慮の上、調整する予定です。

※派遣に伴い、約3週間のガイダンス及び語学研修等を7月中旬～8月上旬に予定しています。

(2) 派遣先と派遣人数

大学名	国	募集人数
カンピナス州立大学	ブラジル連邦共和国	1名
メキシコ国立工科大学	メキシコ合衆国	1-2名

(3) プログラム内容（予定）

- ・ポルトガル語もしくはスペイン語語学研修

※派遣先大学の事情により、参加希望数が一定数に満たない場合開講されない場合もあります。

- ・ラボワーク（4週間程度） ※英語で実施されます。
- ・現地企業訪問 等

(4) 派遣費用

渡航費・滞在費等については、大学が負担します（渡航費：大学負担、滞在費：月額6万円）。

※滞在費支給にあたっては、一定の成績基準を満たす必要があります。

※パスポート申請費用、ビザ（査証）申請費用、海外旅行保険、現地での移動に係る経費、予防接種、飲食代（朝・昼・夕）、土産代などについては、自己負担となります。

(5) 単位認定

学域1年生、学部2・3年生は、「海外語学研修Ⅰ」の履修により1単位を取得することができます。

大学院生は、「大学院海外語学研修Ⅰ」の履修により1単位を取得することができます。

3. 応募・選考

(1) 応募資格

①学域・学部生、大学院生

※原則、留学生は対象外となります。

②十分な英語力を有すること ※ラボワークは英語で実施されます。

③事前学習（7月中旬～8月上旬の予定）等に必ず参加すること

④受入れの留学生とともに学びながら授業・フィールドワークをサポートし、日本での生活などを助け合う「バディ制度」に協力する意思があること

※ 本事業は、我が国にとって戦略的に重要な国・地域との高等教育ネットワークの構築を図ることにより、我が国の大学の世界展開力を強化するとともに、グローバルな通用性を涵養し意識を向上させる取組や留学を促進するための環境整備等の学生のグローバル化を推進するための取組、さらに海外の卓越した大学との連携や大学改革により徹底した国際化を推進することにより、グローバルな社会で活躍できる人材の育成を図ることを目的としています。このような理由から、応募者の審査に当たっては、年齢を含め総合的に判断致します。

(2) 応募書類

①申請書

②英語力を証明できる書類を提出すること（コピー可）

(3) 応募・選考スケジュール

公募期間：2019年4月8日（月）～5月24日（金）

書類審査及び面接審査を行う予定です。詳細はメール等で通知します。

(4) 選考基準

第一次選考（書面審査）

学力、語学力、申請書等から総合的に評価する。

第二次選考（面接審査）

プログラムへの志望動機・本プログラムへの抱負に関する質疑応答により、学力とともに本プログラムへの理解と意欲などについて総合的に評価する。

4. 問い合わせ・応募書類提出先

国際課留学生交流係 東2号館 117号室

TEL：042-443-5117 / 042-443-5966

E-mail：ryugakusei-k@office.uec.ac.jp